

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 17 年 10 月 20 日 (2005.10.20)

【公開番号】特開 2004-31432 (P2004-31432A)
 【公開日】平成 16 年 1 月 29 日 (2004.1.29)
 【年通号数】公開・登録公報 2004-004
 【出願番号】特願 2002-181809 (P2002-181809)
 【国際特許分類第 7 版】

H 0 1 L 25/065

H 0 1 L 21/60

H 0 1 L 25/07

H 0 1 L 25/18

【F I】

H 0 1 L 25/08 Z

H 0 1 L 21/60 3 2 1 E

【手続補正書】
 【提出日】平成 17 年 6 月 21 日 (2005.6.21)
 【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】特許請求の範囲
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

実装基板と、

上面に電極パッドを有する第 1 の半導体チップと、

上面に電極パッドを有する第 2 の半導体チップと、

上面に電極パッドを有する第 3 の半導体チップと、を有し、

前記第 1 の半導体チップ及び前記第 2 の半導体チップが、それぞれの下面を前記実装基板に対向させ、互いに接着テープ上の導体パターンを介して電氣的に接続され、かつ、互いの側面同士を近接させて、前記実装基板上に搭載されており、

前記第 3 の半導体チップが、前記第 1 の半導体チップ及び前記第 2 の半導体チップの上面上に、前記互いに近接された側面の上に位置するように搭載され、

前記第 3 の半導体チップの電極パッドが、前記実装基板とボンディングワイヤを介して電氣的に接続され、

前記第 1 の半導体チップの電極パッドのいくつかと、前記第 2 の半導体チップの電極パッドのいくつかと、前記実装基板とボンディングワイヤを介して電氣的に接続され、

前記接着テープ及び前記接着テープ上の導体パターンが、前記互いに近接された側面の上を跨っており、

前記第 3 の半導体チップが、前記接着テープ上に配置されていることを特徴とする半導体装置。

【手続補正 2】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 0 9
 【補正方法】変更
 【補正の内容】

【0 0 0 9】

【課題を解決するための手段】

この発明の半導体装置は、実装基板と、上面に電極パッドを有する第１の半導体チップと、上面に電極パッドを有する第２の半導体チップと、上面に電極パッドを有する第３の半導体チップと、を有し、前記第１の半導体チップ及び前記第２の半導体チップが、それぞれの下面を前記実装基板に対向させ、互いに接着テープ上の導体パターンを介して電氣的に接続され、かつ、互いの側面同士を近接させて、前記実装基板上に搭載されており、前記第３の半導体チップが、前記第１の半導体チップ及び前記第２の半導体チップの上面上に、前記互いに近接された側面の上に位置するように搭載され、前記第３の半導体チップの電極パッドが、前記実装基板とボンディングワイヤを介して電氣的に接続され、前記第１の半導体チップの電極パッドのいくつかと、前記第２の半導体チップの電極パッドのいくつかと、前記実装基板とボンディングワイヤを介して電氣的に接続され、前記接着テープ及び前記接着テープ上の導体パターンが、前記互いに近接された側面の上を跨っており、前記第３の半導体チップが、前記接着テープ上に配置されているものである。

【手続補正３】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】００１０

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正４】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】００１１

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正５】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】００１２

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正６】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】００１３

【補正方法】削除

【補正の内容】